

**TAZMO**

# タツモ株式会社 決算説明資料

2025年12月期第3四半期

2025年11月14日

証券コード 6266

# INDEX

## 目次



1. 2025年12月期第3四半期 連結業績
2. セグメント情報
3. 市場（顧客）の状況
4. 補足資料



1

# 2025年12月期第3四半期 連結業績

## 売上高

27,114百万円

前年比 +9.6%

## 営業利益

4,423百万円

前年比 △3.9%

## 経常利益

4,454百万円

前年比 △1.5%

親会社株主に帰属  
する中間純利益

3,175百万円

前年比 +2.6%

## ■ 概況

- 売上高は、プロセス機器事業で検収遅れや見込んでいた新規受注が取れなかったことなどにより計画を下回って推移。結果、通期売上計画も大きく下回る見込みとなり修正。利益では半導体装置の量産による原価低減・収益性の改善効果によって計画は達成できる見通し。
- 表面処理用機器事業と金型・樹脂成形事業においては、順調に推移。
- プロセス機器事業の受注状況は、搬送機器、洗浄機で想定以上に苦戦している。アドバンスドパッケージ向け半導体装置については、昨年までの勢いは感じられないが受注はできている。

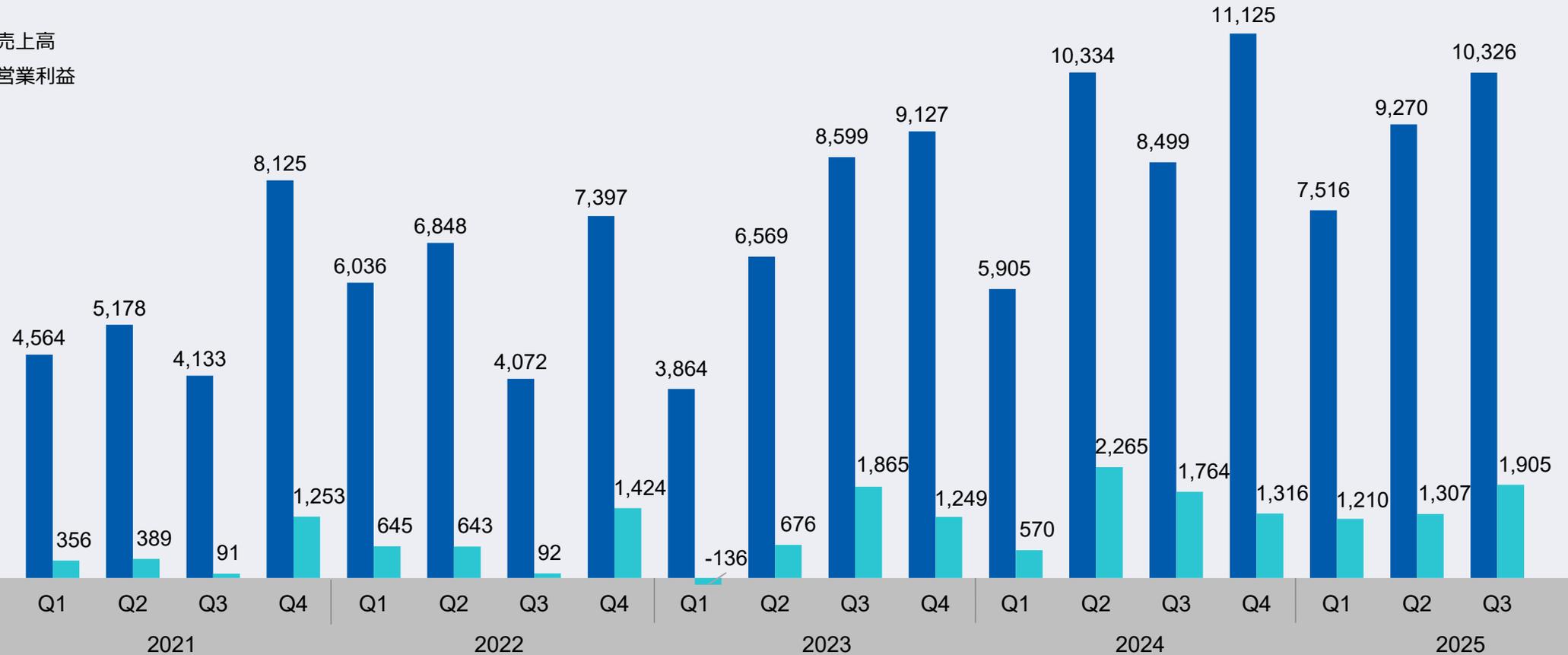
# 2025年12月期第3四半期 連結業績

(百万円)	2024年12月期 Q3 実績	2025年12月期 Q3		前年同期比 増減率(%)	修正後 2025年12月期 計画 (増減額)	進捗率 (%)	参考： 2025年12月期 当初計画
		実績	売上比(%)				
売上高	24,739	27,114	—	9.6	36,000 (△5,000)	75.3	41,000
売上総利益	8,661	8,512	31.4	△1.7	—	—	—
営業利益	4,601	4,423	16.3	△3.9	5,000	88.5	5,000
経常利益	4,524	4,454	16.4	△1.5	5,100	87.3	5,100
親会社株主に 帰属する 当期純利益	3,094	3,175	11.7	2.6	3,500	90.7	3,500

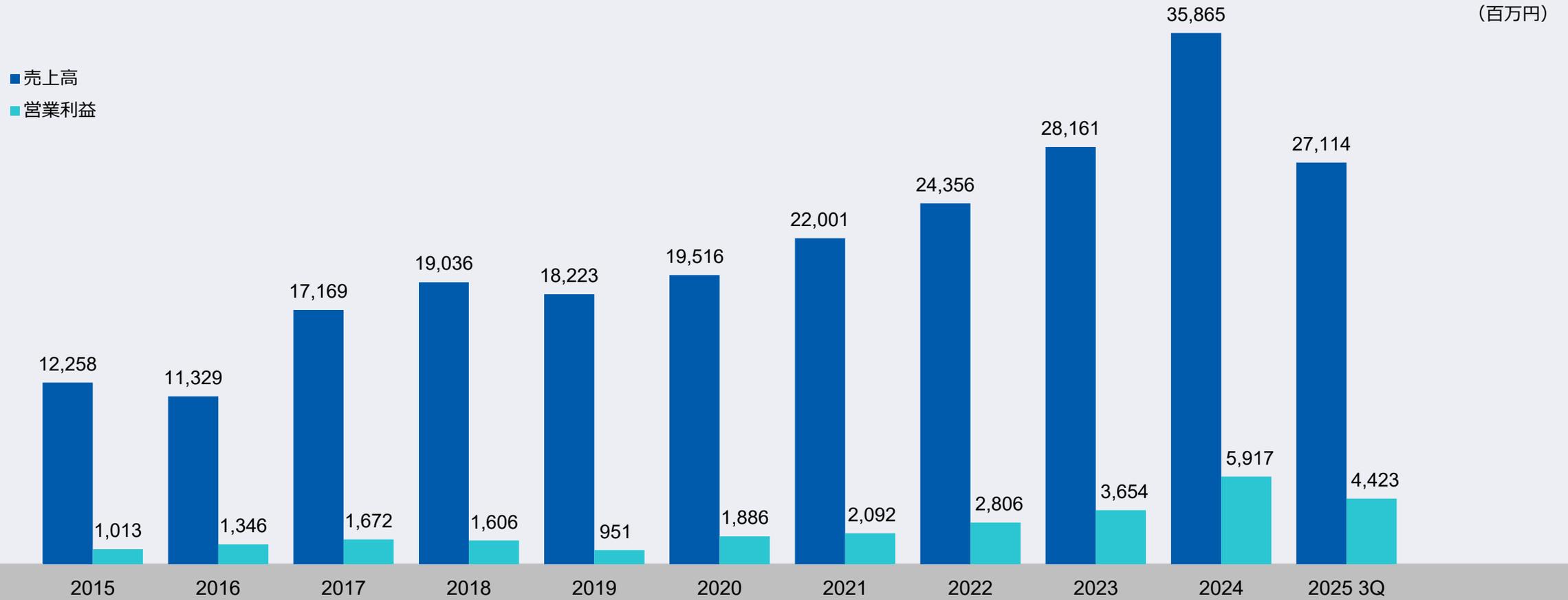
# 連結売上高・連結営業利益推移（四半期）

(百万円)

■売上高  
■営業利益



# 連結売上高・連結営業利益推移（通期）



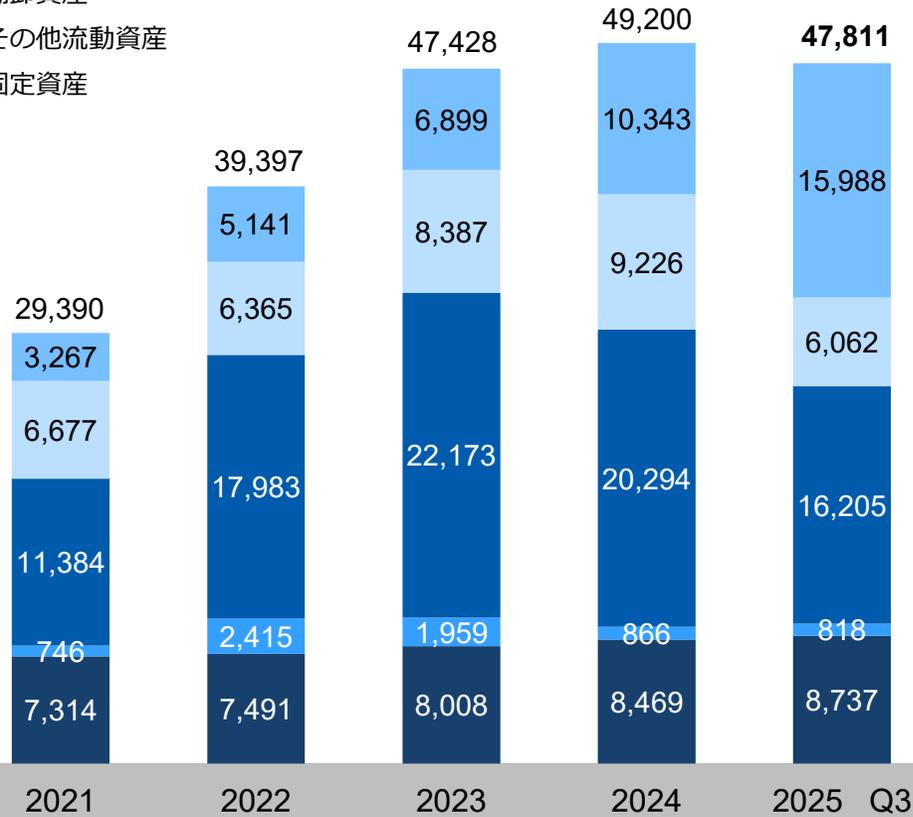
(百万円)	2024年12月期	2025年12月期 Q3	前期末比増減
流動資産	40,731	39,073	△1,657
固定資産	8,469	8,737	268
有形固定資産	7,385	7,674	289
無形固定資産	156	164	7
投資その他資産	927	898	△29
<b>総資産合計</b>	<b>49,200</b>	<b>47,811</b>	<b>△1,388</b>
流動負債	17,696	15,353	△2,342
固定負債	6,861	6,151	△710
<b>負債合計</b>	<b>24,557</b>	<b>21,504</b>	<b>△3,053</b>
<b>純資産合計</b>	<b>24,642</b>	<b>26,306</b>	<b>1,664</b>
自己資本比率	49.1%	54.1%	5.0P

## 主な増減要因

<b>流動資産</b>	(百万円)
現金及び預金	+5,644
受取手形及び売掛金	△2,185
電子記録債権	△978
棚卸資産	△4,089
<b>流動負債</b>	
電子記録債務	△2,585
未払法人税等	△679
契約負債	823
<b>固定負債</b>	
長期借入金	△651

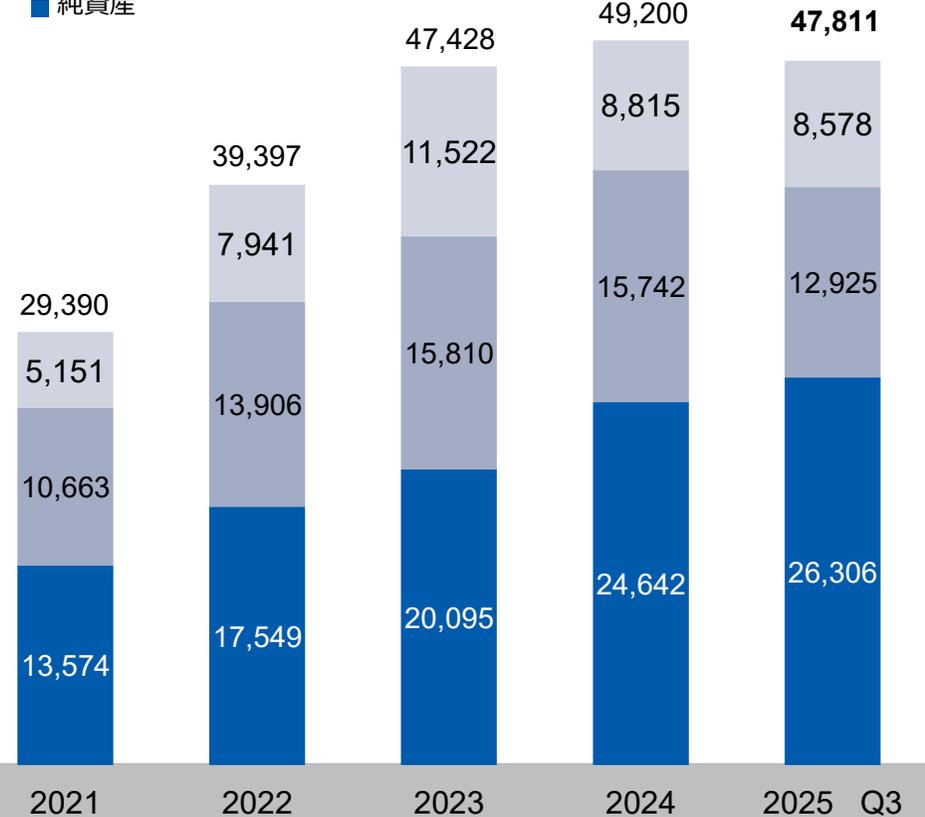
## 資産

- 現金及び預金
- 売掛債権
- 棚卸資産
- その他流動資産
- 固定資産



## 負債／純資産

- 有利子負債
- その他負債
- 純資産



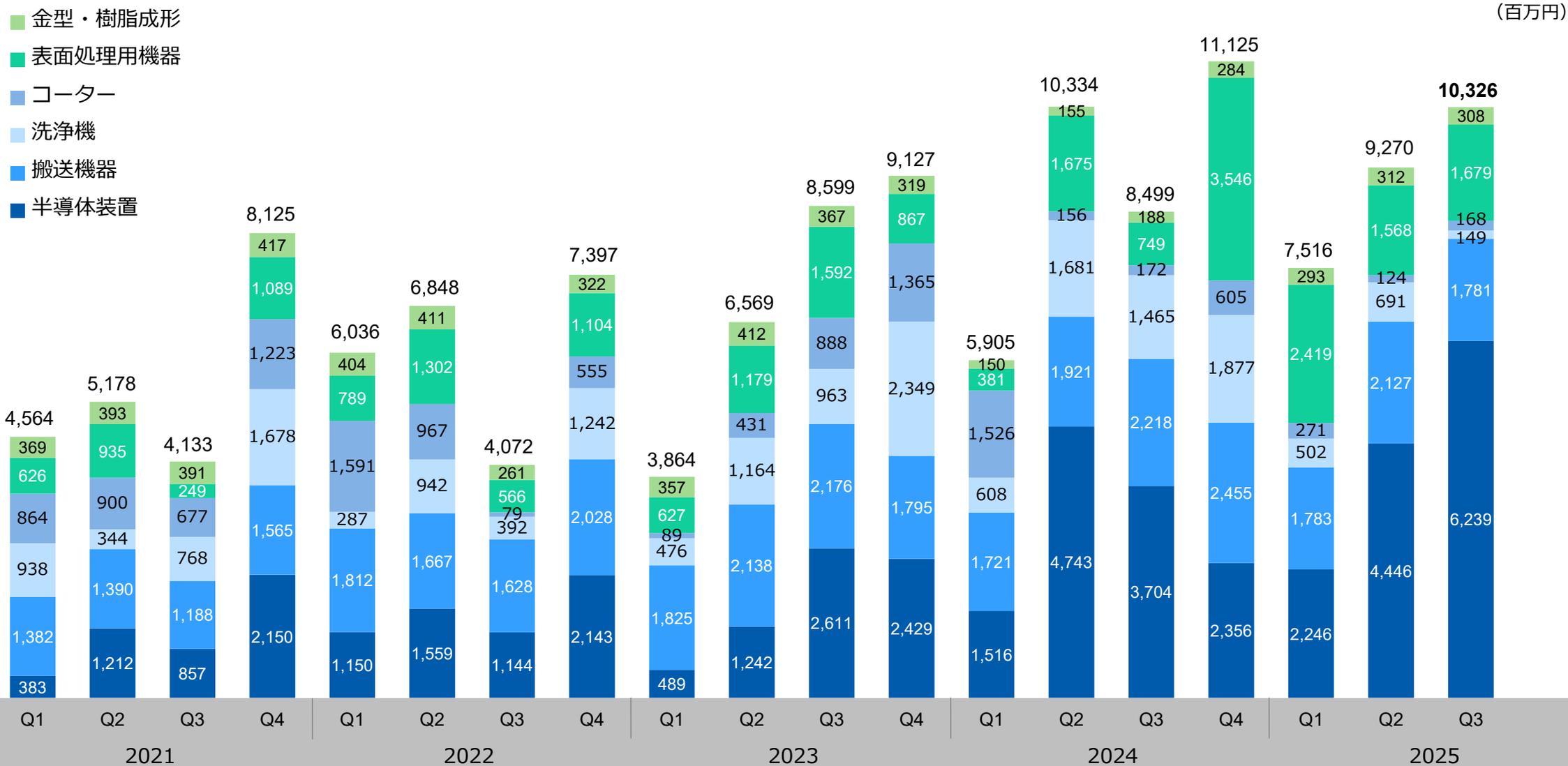


2

# セグメント情報

		2024年12月期 Q3 実績	2025年12月期 Q3 実績	前期比 増減率(%)	2025年12月期 当初計画	当初計画比 進捗率(%)	
		(百万円)					
プロセス機器事業	売上高	21,438	20,533	△4.2	33,000	62.2	
	営業利益	4,491	3,566	△20.6	4,500	79.2	
	■ 半導体装置	売上高	9,964	12,931	29.8	18,200	71.0
	■ 搬送機器	売上高	5,862	5,692	△2.9	9,300	61.2
	■ 洗浄機	売上高	3,756	1,343	△64.2	3,700	36.3
■ コーター	売上高	1,855	564	△69.6	1,800	31.3	
金型・樹脂成形事業	売上高	494	915	84.9	1,100	83.2	
	営業利益	△217	95	—	50	—	
表面処理用機器事業	売上高	2,805	5,666	101.9	6,900	82.1	
	営業利益	322	733	127.6	450	162.9	
セグメント間調整	営業利益	5	28	—	—	—	
合計	売上高	24,739	27,114	9.6	41,000	151.2	
	営業利益	4,601	4,423	△3.9	5,000	113.0	

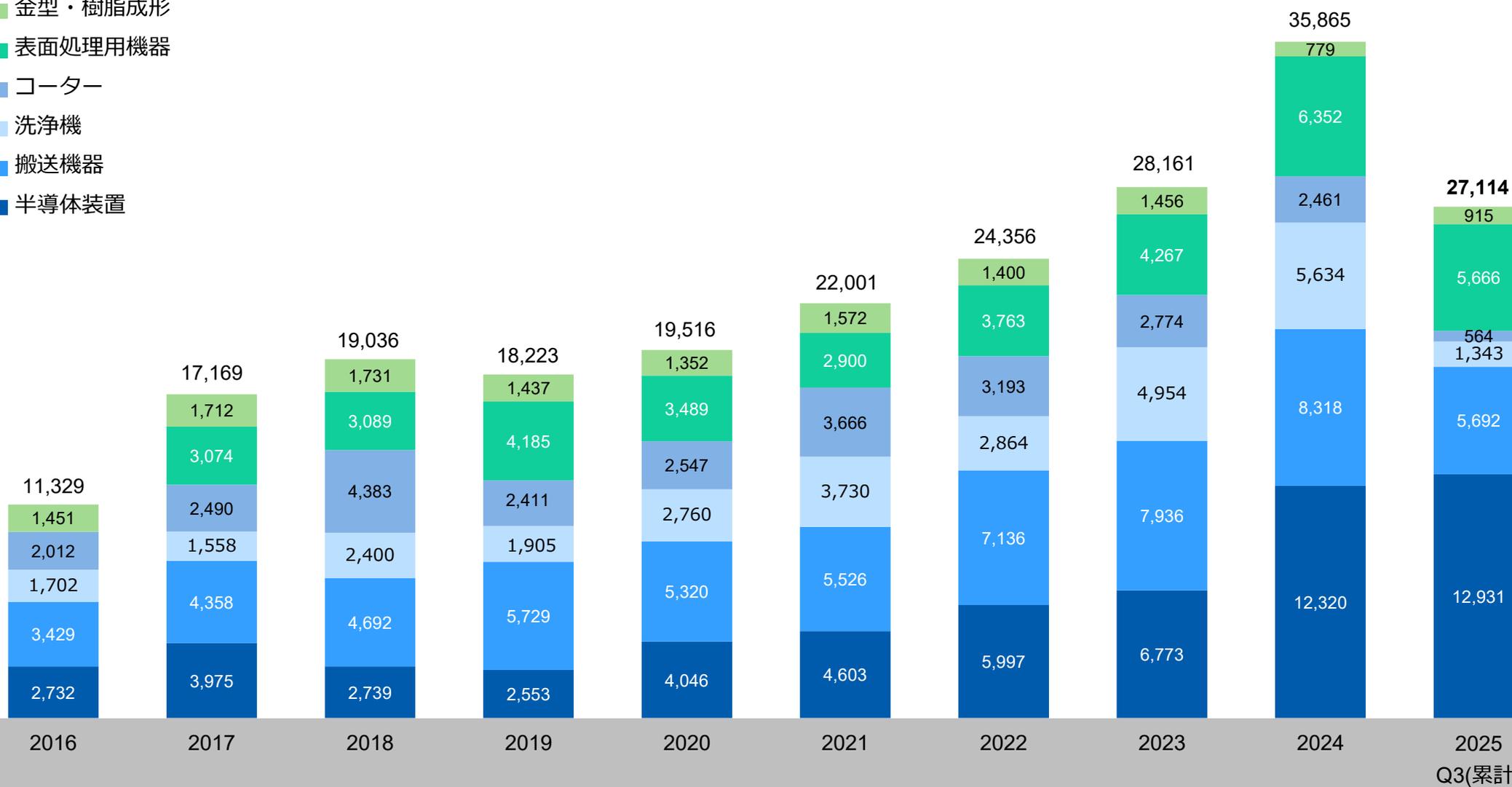
# セグメント別 売上高推移 (四半期)



# セグメント別 売上高推移 (通期)

(百万円)

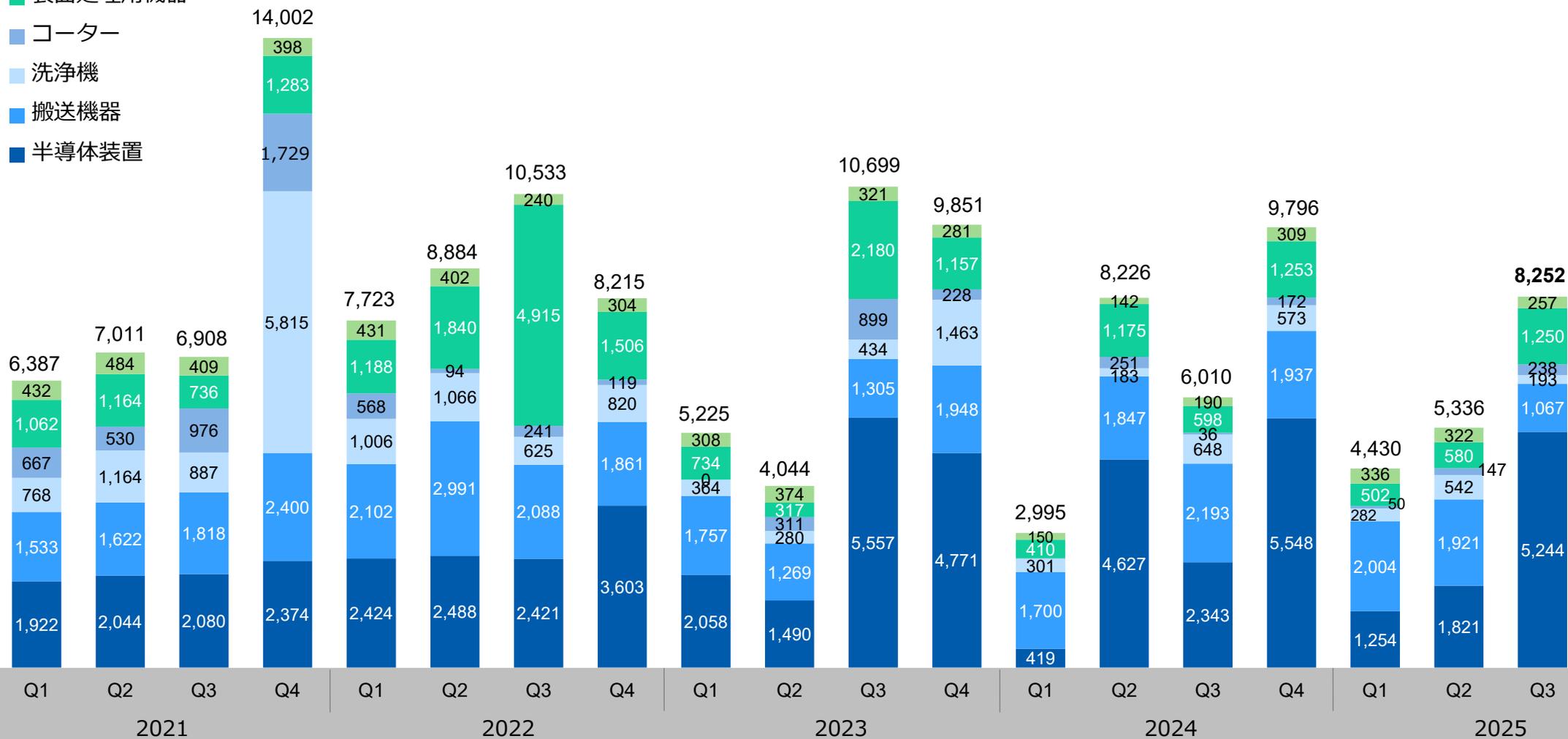
- 金型・樹脂成形
- 表面処理用機器
- コーター
- 洗浄機
- 搬送機器
- 半導体装置



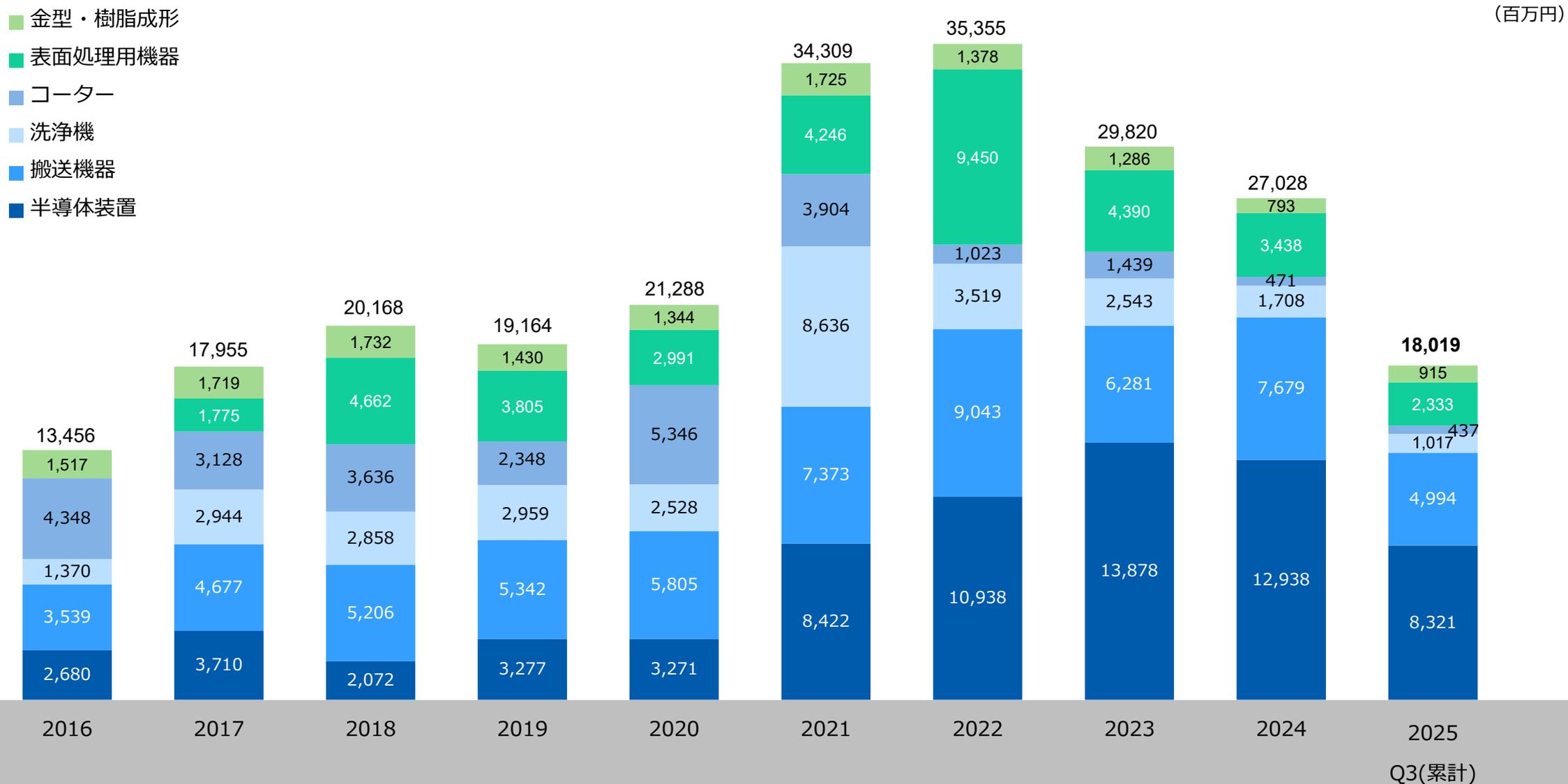
# セグメント別 受注高推移 (四半期)

(百万円)

- 金型・樹脂成形
- 表面処理用機器
- コーター
- 洗浄機
- 搬送機器
- 半導体装置



# セグメント別 受注高推移 (通期)



# セグメント別 受注残高推移

(百万円)





3

## 市場（顧客）の状況

- 半導体製造装置では、アドバンスドパッケージ向け装置でまとまった受注があった。小口案件が増加。パワー半導体向け装置は、少しずつ引合いが増えてきており受注にもつながっている。ウェーハ用塗布／現像装置の引き合いも増えてきており、受注すべく営業している。
- PLP（パネルレベルパッケージ）装置の引き合いは、R&D用のものが中心。仕様決めで時間がかかっているが確実に受注できるよう開発・プロセス評価に注力している。今後の市場の拡大を期待している。
- 搬送機器では、ウェーハ用は引き合いが減少。一方、PLP用は引き合いが増加しているが受注にはもう少し時間がかかりそう。受注額の増加に向け開発・営業に注力している。
- スラリー供給装置の引き合いが順調に推移しており、来年度の投資案件が増加している。洗浄装置でも新規案件の話が少しずつ出てきてはいるが、投資時期が先の案件が多くなかなか受注には至っていない。
- 表面処理用機器では、めっき処理を含むウェット処理装置の案件は、本格的な回復には少し時間がかかりそう。ウェット処理及び基板搬送装置共に、新規開発や新規引き合い案件に注力しながら受注拡大に向けて活動している。



# 4

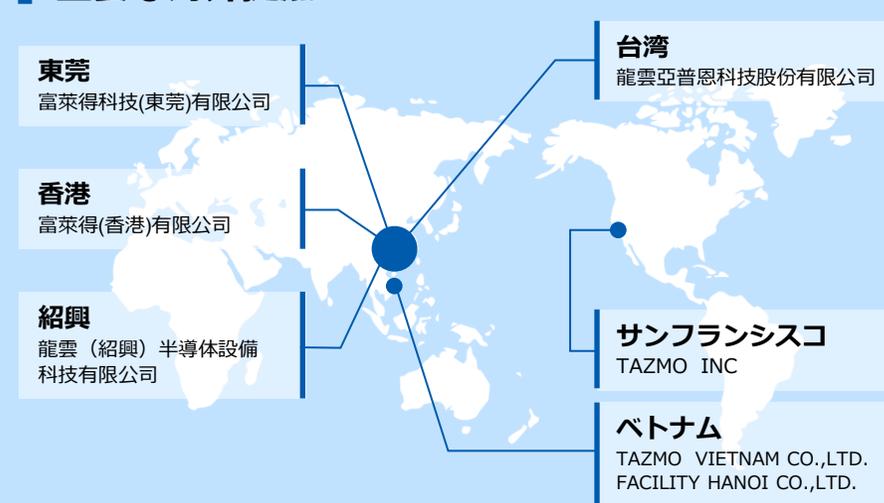
## 補足資料

商号	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	35億6,859万682円
発行済株式数	14,842,354株
株主数	9,701名（2025年6月30日現在）
従業員数	単体 436名／連結 1,180名（2025年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、精密金型・樹脂成形品などの開発・製造・販売

## ■ 主要な国内拠点・関連子会社



## ■ 主要な海外拠点



- 1972** ● - 電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
- 1980** ● - インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始  
- 半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
- 1989** ● - 液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
- 1990** ● - 本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転  
- スーパークリーンルーム用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
- 1994** ● - エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
- 1995** ● - インジェクション成形品の製造・販売を開始
- 2001** ● - 半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、  
- 製造・販売を開始
- 2004** ● - JASDAQ市場に株式を上場
- 2008** ● - TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立
- 2009** ● - 第10世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始  
- 3M社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
- 2013** ● - アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化  
- ロンアン省ロンハウ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
- 2017** ● - 株式会社ファシリティ、株式会社クオークテクノロジーを子会社化
- 2018** ● - 東京証券取引所市場第一部へ市場変更
- 2019** ● - 本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
- 2020** ● - アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併
- 2022** ● - 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行  
- 公募増資により、資本金34億9,540万円へ増資  
- 中国における半導体関連機器の製造・販売拠点として龍雲（紹興）半導体設備科技有限公司を浙江省紹興市に設立

最先端の半導体やパッケージを製造する装置をはじめ、クリーン搬送ロボットなどを開発・製造・販売する事業を展開

## 半導体製造装置事業

半導体製造における塗布・現像・貼合・剥離など、各種プロセスに対応した装置を、40年に渡って培ったノウハウ・技術により、全世界に提供



## 搬送機器事業

半導体製造に欠かせないシリコンウェーハ等の搬送ロボットをはじめ、正確性・スピーディさ・省スペースに対応した各種搬送システムを提供



## 洗浄装置事業

半導体製造の重要な工程であるシリコンウェーハ洗浄・スラリー供給装置や、廃液からリン酸を再生・再利用する装置を提供



## コーター事業

各種フラットパネルディスプレイ用製造装置を提供していたノウハウを生かし、PLP用装置やナノインプリント装置を提供



## 金型・樹脂成形事業

部品製造に欠かせない金型技術は、創業時からのコア技術であり、ユーザー企業の様々なニーズに応える形で各種製品を提供



## 表面処理用機器事業

半導体のパッケージや、自動車等の電子制御システムに組み込まれている、プリント回路基板に対するめっき処理装置の提供

